**各位 お問い合わせ先**

テリー・エマーソン（Terry Emerson）

terry.emerson@samtec.com

812-981-8304

**[SAMTEC LOGO] 2018年6月**

**Samtec社、業界最高水準の極細ピッチ、高密度カードエッジを発表**

0.50 mmのマイクロピッチカードエッジソケットで省スペース、省コスト

**インディアナ州ニューアルバニー：** Samtec社は、業界初となる位置揃えビーム付き0.50 mmピッチのカードエッジソケット（MEC5）を発表しました。本設計は、コンパクト化・高速化のみならず、コストの最適化のニーズに対応しています。

ソケットの位置揃えビームは、カードをコンタクトと正しく位置合わせできるように設計されています。これにより、極細ピッチコネクタでは通常動作しない、標準のPCB公差のカードでの使用が可能になります。製造コストが最適化され、PCBコスト30～50％の省コスト、標準カードの高歩留まりが実現します。

この高密度な極細0.50 mmピッチカードエッジソケットは、より一般的な0.80 mmピッチのソリューションに比べて、優れた省スペース性を提供します。垂直（MEC5-DV）とライトアングル（MEC5-RA）の取り付け方向に対応、本ソケットは高密度アプリケーション向けにI/O トータル300まで対応しています。

業界の高速化ニーズに対応し、垂直ソケットの仕様は、28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4をサポートしています。垂直、ライトアングルのソケットとも、PCIe® Gen 4に対応しています。

Samtec社の高速製品担当マネージャのテリー・エマーソン（Terry Emerson）は、次のように述べています。「MEC5カードエッジシステムを発表することができ大変うれしく思います。MEC5は、すでに幅広い当社のカードエッジの製品群に厚みを加えるものです。極細ピッチで、標準のPCB公差の使用を可能にするのは、業界で現時点では他には例がありません。この特長により、当社のお客様は、嵌合するPCBのコストを抑えながらも、非常に高密度なコネクタから高速信号を通すことが可能になります。」

コンタクト当たりの定格電流は1.5 A、本システムは厚さ1.60 mmのカードに対応しており、標準の位置合わせピンとカード両極性機能を備えています。PCBとの接続をより確実にするために、スルーホールまたは表面実装の堅牢な溶接タブの選択も可能です。

詳細は、Samtec社の[マイクロエッジカードシステム](https://www.samtec.com/connectors/edge-card/high-speed/micro-edge-card)のウェブページをご覧ください。

PCI-SIG®、PCI Express® およびPCIe® ロゴマークは、PCI-SIG の登録商標および/またはサービスマークです。

**Samtec, Inc.について：**

1976年創業のSamtec社は、非上場企業で、年間売上高は7億1,300万ドルに上ります。ICとボード間およびICパッケージ、高速ボード・ツー・ボード、高速ケーブル、ミッドボードおよびパネル・オプティクス、フレキシブル・スタッキング、ならびに小型/堅牢部品およびケーブル等、幅広い電子インターコネクト・ソリューションの製品を有する、世界的な製造業者です。Samtec テクノロジー・センターは、ベアダイから距離100メートルのインターフェースまでのシステムおよびその間のあらゆるインターコネクトポイントに関して、性能・コスト共に最適化するための、技術、戦略および製品の開発・高度化に注力しています。24カ国、33箇所の拠点における、Samtec社の世界的なサポート体制が比類なき顧客サービスの提供を可能としています。より詳しい情報は、Samtec社ウェブサイトをご覧ください（<http://www.samtec.com>）。

**Samtec, Inc.**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**電話：1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)**

[www.samtec.com](http://www.samtec.com)